

Plaskon SMT-B-1RC

Еpoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound optimized specifically for PBGA applications. It is a fast cure molding compound for automold applications. It has the same unique resin system as the SMT-B-1, which minimizes warpage and enables trouble-free molding onto rigid and flexible laminate substrates. Minimal dimensional change after molding, post bake and subsequent solder treatment make this compound an excellent choice for PBGA applications.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Низкая вязкость Ускоренная Настройка		
Используется	Применение в автомобильной области		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.88	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	1.28	MPa	ASTM D790
215°C	0.588	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.00971	MPa	ASTM D790
215°C	0.00402	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	226	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.80	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	2.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	28	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.90		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	4.0E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: <5°C
Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months
Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days
Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days
Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 105 cm
Automatic Orifice Viscosity, 175°C: 55 poise
Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 12 sec
Ash Content: 78 %
Hydrolyzable Halides: <1 ppm
Cull Hot Hardness, Shore D, 75 sec, 175°C: 86
Volume Resistivity, 22°C: 2e16 ohm-cm
All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 15 cm⁻⁶/cm/°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 55 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:
Preheat Temperature: 85 to 98°C
Molding Temperature: 175°C
Molding Pressure: 800 to 1200 psi
Cycle Time, 175°C: 60 to 150 sec
Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat